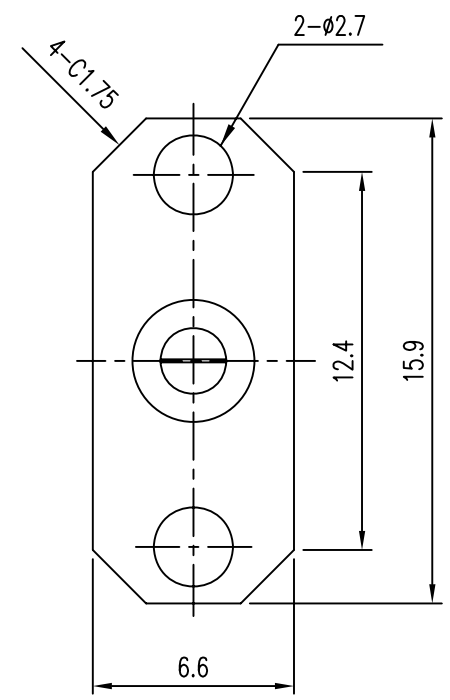
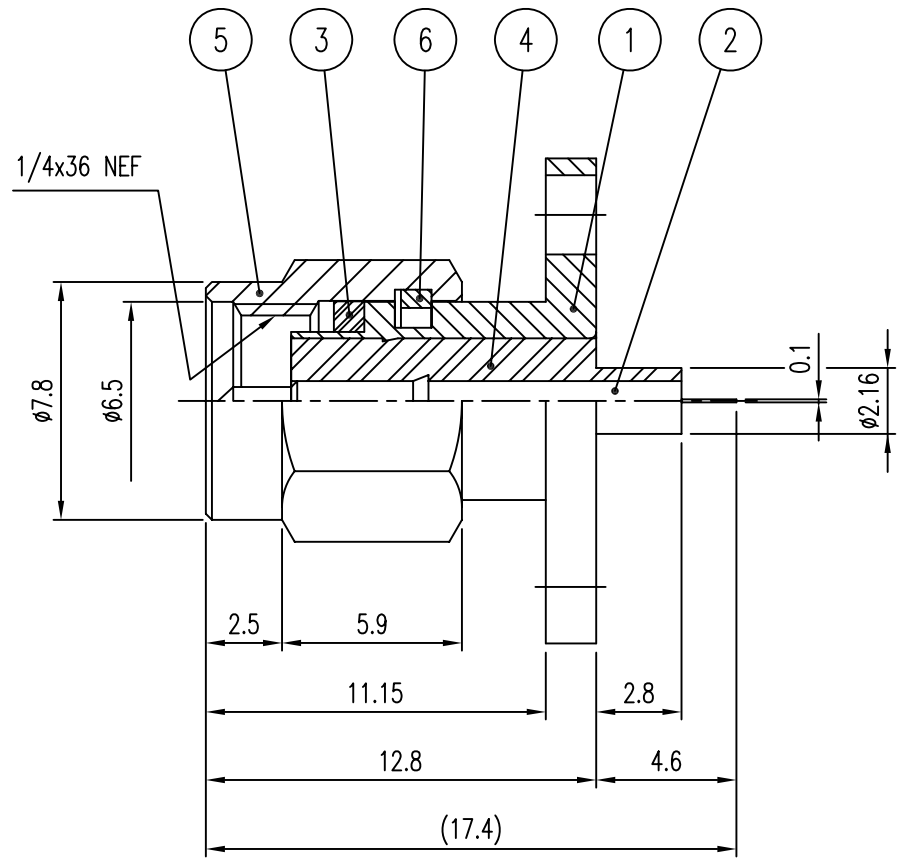


ST	가공										수정내역			
											부호	내 용	수정자	승인자
ST(기초)										1	(첨변No.201710-0007) 배타 내부 넘시매출 추가	은선영	김인철	2017. 10. 20.
ST(개선)														



6	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00002-N5/1 (R2001)
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-135/1 (K2001)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00210-N/1 (H2022)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00004-N/1 (G2001)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00322-135/1 (F2024)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00346-135/1 (D2037)

대체가능재질	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일	2000. 12. 21.				
재질	승인					
열처리	검도					
보호피막처리	재도					
	작성부서	연구소				
	척도	4/1	단위	mm	총량	

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

KJ COMTECH CO.,LTD.

도명

SP-P2

도번

CN00137-7/1

K314-484-003